



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H1500 取向化系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

鸿富诚 H1500 取向化导热硅胶主要填充低比重、高导热填料为主，运用独特的定向技术，将填料所具有的高热传导率特性发挥到了极致，由于较低的填充比例，使材料具有很好的韧性和表面柔软性，能更有效地填充空气间隙，减少界面热阻，且其具有极高的导热系数，是一种非常理想的导热材料。

应用特点：

- 表面柔软，可压缩性好
- 低热阻
- 轻质化
- 低压力下应用
- 良好的热稳定性能

应用领域推荐：

- 军工
- 雷达
- 大型服务器
- GPU、图像处理器
- 高频网通设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30°C

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	黑色	---	目视
标准尺寸	150*150	mm	ASTM D 5947
厚 度	0.5~2	mm	ASTM D374
硬 度	45±5	Shore 00	ASTM D 2240
密 度	1.5±0.2	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.12	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥200	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥40 (@50Psi)	%	ASTM D 695
TML	0.49	%	ASTM E 595
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~180	°C	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	15.0	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	≤0.2 (@20Psi/1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

体积电阻率	≥10 ¹⁰	Ω·cm	ASTM D 257
介电常数	15	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权